

발행규정

1993. 5. 17 제정 / 2010. 2. 18 개정

제 1 조 (목적) 이 규정은 (사)한국 마이크로전자 및 패키징학회(이하 본 학회) 정관 제 6 장 제 34 조에 의하여 본 학회에서 발행하는 모든 학술지 발행에 관한 일반적 사항을 규정하는 것을 목적으로 한다.

제 2 조 (학술지 및 언어)

- 1) 본 학회는 국영문 학술지로 “한국 마이크로 전자 및 패키징 학회지(Journal of the Microelectronics and Packaging Society)”를 발행한다. 단, 본 학회지는 "J. Microelectron. Packag. Soc." 로 인용한다.
- 2) 학술지의 사용언어는 학술지 투고규정에 따른다.

제 3 조 (발행 시기) “한국 마이크로 전자 및 패키징 학회지”는 연 4 회 3 월, 6 월, 9 월, 12 월 30 일에 발행한다. 이 때, 편집담당 이사는 매호 발행 이전에 편집위원회 회의에 그 편집내용을 보고하고 확정한다.

제 4 조 (논문투고 및 게재심사) 학술지에 투고된 논문은 학술지의 투고규정을 준수해야 하며, 논문 게재 여부는 논문심사규정에 따른 심사절차를 통하여 편집위원회에서 결정한다.

제 5 조 (판권) 학술지에 게재된 논문 및 이를 가공한 전자출판 형태의 업적에 대한 판권은 본 학회가 보유한다. 판권의 양도 및 대여에 관한 사항은 이사회에서 결정에 따른다.

제 6 조 (배포) 학술지는 본 학회의 회원들에게 무상으로 배포한다. 회원이 아닌 개인이나 단체에서 구독을 요청할 경우 이의 승인 및 구독료는 이사회에서 결정한다.

제 7 조 (창간, 증간 및 폐간) 새로운 학술지를 창간하고자 할 경우나 기존의 학술지 간행 횟수를 변경 혹은 폐간하고자 할 경우에는 이사회에서 이를 결정한다.

부 칙

1. 제정 일자 : 1993 년 5 월 17 일
2. 1 회 개정일자 : 1998 년 6 월 30 일
3. 2 회 개정일자 : 2010 년 2 월 18 일
4. 본 규정은 2010 년 2 월 18 일부터 적용한다.